

# 110年度半導體產學研發聯盟計畫

## 徵求說明書

# 目錄

壹、背景說明 .....	- 3 -
貳、徵求計畫 .....	- 3 -
參、審查重點 .....	- 4 -
肆、申請辦法及相關資訊 .....	- 5 -
伍、其他事項及聯絡窗口 .....	- 7 -

# 110年度半導體產學研發聯盟計畫

## 徵求說明

### 壹、背景說明

半導體是全球高科技產業競爭的核心。環顧世界，我國半導體產業發展位居全球半導體的領先地位。109年我國晶片設計業排名世界第二，僅次於美國；晶圓代工與晶片封測業則是連續蟬聯世界第一。在半導體領域的研究方面，透過學術界的努力與政府的長期支持下，也具有舉足輕重的國際頂尖研究能量。現在，面對當前國際貿易、產業發展局勢變動與競爭對手躍進，為了在全球半導體產業競爭中贏得先機，必須進一步串聯政府、產業界及學術界的研發資源，在產業前瞻技術研究與高階研發人才培育上進行布局，期能共同提升我國半導體產業各領域的競爭力。

著眼於國家科技、經濟與產業發展的迫切需求，科技部（以下簡稱本部）鼓勵國內產業界與學術界組成半導體產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界、學術界結合研發能量，共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，以強化產業發展的關鍵技術研發及智財布局，更協助產業界、學術界共同培育高階研發領導人才。

### 貳、徵求計畫

為提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力，並擴大半導體領域產學合作規模，本部自110年度起推動「半導體產學研發聯盟計畫」，即日起受理線上申請，請申請計畫主持人至本部網站填寫申請書。申請機構須於110年2月19日(星期五)前彙整申請者資訊及造冊，函送本部，逾期恕不受理。相關申請事宜如下：

#### 一、申請資格

- (一) 申請機構（即執行機構）：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第二點規定者。
- (二) 計畫主持人（申請人）及共同主持人：符合本部「補助專題研究計畫作業要點」第三點規定者。
- (三) 合作企業：現金出資不得少於新臺幣200萬元，須於計畫執行期間內撥付，且應高於向本部申請補助經費，並符合本部「補助產學合作研究計畫作業要點」第二點規定者。

#### 二、申請注意事項

- (一)計畫執行期間自110年4月1日起至111年3月31日；申請機構得申請多年期計畫（至多三年），本部將依審查結果決定是否核給分年核定多年期計畫。
- (二)分為 IC 設計、製造及封測三組，請於申請書之計畫名稱註明申請組別。
- (三)計畫申請書應檢附：「計畫推薦機構審核資料」（如附件1）、「申請人與企業之合作約定書」（如附件2）函送本部，其中「計畫推薦機構審核資料」須以密封形式函送本部，本部將依申請人建議之推薦機構，將「計畫推薦機構審核資料」送推薦機構進行審核；另本部辦理計畫審查時，得通知申請人到部報告。
- (四)除前述申請程序外，如申請人與計畫推薦機構取得協議，可由該推薦機構直接受理申請人提出之計畫推薦機構審核資料，並依審核結果出具推薦計畫證明文件（如附件3）後，再另向本部提出申請書。計畫推薦機構得依本計畫「計畫推薦機構審核資料」之格式規範（如附件1），包含但不限於本部格式，設計受理推薦計畫之構想書表；惟於受理推薦申請前，應函報本部備查。
- (五)前揭之推薦機構，係指我國與本次徵求領域相關之產業公協會等機構，其設立運作非以接受政府補助為主，且其宗旨應包括促進產學合作、推動產業前瞻技術研發，須確認計畫內容為業界認可之產業前瞻技術研究，還有與吸引業界提供經費投入研發內容之關聯性等。
- (六)申請書下載路徑：<https://www.most.gov.tw/?l=ch/學術研發服務網登入/學術獎補助申辦及查詢/專題研究計畫>，計畫類別為「半導體產學研發聯盟計畫」。
- (七)申請機構應於公告受理期間內向本部提出申請，逾期不予受理。
- (八)計畫申請書審查期間自申請文件完整交付之次日起三個月內完成；必要時，得予以延長。審查期間不含補正及陳述意見之期間。
- (九)本部依審查結果核給補助額度。計畫未獲通過補助者，不得提出申覆。

## 參、審查重點

本部得依計畫之領域性質及特色，聘請企業界、學術研究機構、科技行政單位之學者專家，組成審查小組，負責計畫審查，審查作業包括初審書面審查及複審會議審查，如有必要將安排申請人簡報計畫內容，計畫簡報複審會議時間及地點，將另行通知。審查原則如下：

- 一、計畫內容須以具國際競爭性之產業前瞻技術研究為主。
- 二、研究項目及經費需求合理性。
- 三、計畫期中及全程之預期績效及其達成情形。
- 四、計畫團隊研究群之執行能力、過去執行產學合作計畫之績效、預期研發成果及產業外溢效果等。
- 五、合作企業之資格、研發能力或潛力、出資、承接計畫成果之後續規劃及協助我國相關產業發展之效益。
- 六、吸引業界投入經費之相關證明文件。
- 七、申請計畫是否包含下列高階人才培育規劃之優先補助參考情事：

- (一) 博士研究生或博士級研究人員參與研究計畫者，得做為優先補助之審查參考。
- (二) 業界承諾額外資助博士班研究生獎學金者。
- (三) 業界有吸納計畫內博士班研究生或博士級研究人員誘因相關承諾者，於申請時須一併提供相關證明文件。

## 肆、申請辦法及相關資訊

### 一、執行規範

(一) 本部得補助下列項目所需費用：

1. 業務費：

(1) 研究人力費：

A. 專、兼任人員費用及臨時工資。

B. 博士級研究人員費用；

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用：與本聯盟產學合作計畫直接有關之其他費用等。

2. 研究設備費。

3. 管理費。

4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。

(二) 吸引業界投入經費須為現金出資，不得少於新臺幣200萬元，且須高於向本部申請補助經費，得支應下列費用：

1. 研究主持費：由執行機構、主持人及合作企業共同商議。

2. 業務費：

(1) 研究人力費：專、兼任人員、博士級研究人員等研究人力費用。

(2) 耗材、物品、圖書及雜項費用。

3. 研究設備費。

4. 國外差旅費：出席國際會議差旅費、國外或大陸地區差旅費。

5. 管理費。

(三) 博士級研究人員得因執行計畫需要至合作企業參與研發，其工作內容、期間等相關事項由計畫執行機構以契約明定。

(四) 業界投入經費須於本計畫執行期間內撥付。

(五) 業界提供經費應使用於計畫之執行或與計畫執行相關之事項，不得任意支用。

(六) 博士班研究生參與本計畫之研究人力費用，本部至少每位每月補助2萬元，業界每位每月至少投入2萬元。博士班研究生除原依規定支領研究計畫兼任助理費用外，另得依「科技部鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，於本計畫補助期間內，企業補助每人每月支領新臺幣1萬元以上之獎學金者，本部專款補助與企業同額之獎學金，惟以每月2萬元為上限，申請人可於計畫申請時備齊「科技部鼓勵企業參與培育博士

研究生試辦方案」相關文件一併提出。

- (七) 執行機構應於計畫執行期間結束三個月前向本部完成請領第二期補助經費款項，並檢附提供參與計畫博士研究生獎學金之相關證明文件及業界全額出資證明文件（如匯款或即期支票影本）。若執行機構未能於請領第二期補助經費款項期間完成請領及未出具前述相關證明文件，執行成效未達計畫查核點或本計畫相關規定者，得要求計畫申請機構限期改善，必要時得終止計畫或要求繳回部分經費，並納入本部後續補助之參考。
- (八) 計畫內核給博士級研究人員及博士班研究生經費，如因研究計畫需要，得報經本部同意變更後，於研究人力費內調整運用。
- (九) 執行機構應制定研發成果之規範或整體機制，以加強研發成果之管理、推廣及運用，具體落實推動產學合作之目標。
- (十) 合作企業提供研究經費、撥付管理與使用、申請補助項目、其他與計畫相關之權利義務等，應事先以書面約定。

## 二、研發成果

- (一) 屬於本部補助之部分，除經本部認定歸屬本部所有者外，全部歸屬計畫執行機構所有；屬合作企業出資部分，由計畫執行機構與合作企業依相關法令規定商議約定之。
- (二) 計畫主持人於本計畫執行期間變更所屬單位時，其研發成果之歸屬、管理及運用等相關問題，由變更前、後所屬單位與計畫主持人議定之，並由計畫執行機構函報本部同意後辦理。
- (三) 研發成果歸屬申請機構所有之部分，合作企業於計畫結束一年內，有優先協商授權或讓與之權利，授權或讓與內容由申請機構與合作企業約定之。
- (四) 運用研發成果所獲得之收入分配予申請機構之比率，依政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法辦理。
- (五) 計畫執行機構、計畫主持人及合作企業運用或推廣研發成果時，在未獲得本部書面同意前，不得在利用研發成果時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），引用本部之名稱、部徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示本部與計畫執行機構及合作企業有任何關連。合作企業若違反前開規定，計畫執行機構或計畫主持人應立即通知本部為必要之處理。
- (六) 計畫執行機構、計畫主持人在研發成果獲准專利後，應明確標示專利證書號數。

## 三、結案報告

- (一) 計畫結束後三個月內，執行機構應向本部繳交計畫研究成果精簡報告及完整結案報告（電子檔），並將產生之研發成果及對產業技術提升之績效等相關資料，辦理登錄作業，並具體展示。

- (二) 二年期以上計畫，應於當年計畫結束三個月前線上繳交當年計畫執行之精簡進度報告及完整進度報告以供審核，做為下年度之執行依據。
- (三) 計畫主持人對前項計畫之精簡報告、完整報告及研發成果實際運用績效登錄等內容，應負完全責任。如因涉及專利、技術移轉案或其他智慧財產權等，而不宜對外公開者，請勿將其列入精簡報告，原則上本部將公開精簡報告。

#### 四、計畫管考

- (一) 計畫將依審查結果核定之查核點，進行期中考核計畫執行成效，並得於執行期間增訂查核點，作為計畫考核之依據。
- (二) 執行成效未達計畫查核點或本計畫相關規定者，得要求計畫申請機構限期改善，必要時得終止計畫或要求繳回部分經費。
- (三) 經核定執行之計畫，由申請機構負責督導，並加強管考機制。執行成效不彰者或未能配合本計畫申請、執行及管理之各項規定者，本部得視情節輕重終止補助、追繳補助經費。
- (四) 本部就計畫主持人提供之研究成果完整結案報告之發表內容及研發成果對產業技術提升績效登錄內容等，得進行查核及要求改善；未能達成績效或中途退出者，除有正當事由外，本部得視情節停止計畫主持人於一定期間內向本部申請各項獎、補助計畫經費。

#### 伍、其他事項及聯絡窗口

- 一、計畫經審查列為國家核心科技研究計畫者，執行時，申請機構、計畫主持人及合作企業應依政府資助國家核心科技研究計畫安全管制作業手冊之規定，建立安全管理制度，並應遵守相關法令規定及本部之相關保密要求。如未依規定辦理，除應負法律責任外，本部得視情節輕重停止計畫主持人於一定期間內向本部申請各項獎、補助計畫經費，並追回該研究計畫補助款。
- 二、其他未盡事宜，準用本部補助產學合作研究計畫作業要點、本部補助專題研究計畫作業要點與經費處理原則，以及其他相關法令規定辦理。

#### 三、計畫申請聯絡窗口

科技部半導體產學研發聯盟計畫辦公室

聯絡人：陳于純小姐

電話：02-2737-7288

信箱：yuchchen@narlabs.org.tw

科技部產學及園區業務司

承辦人：林技寬先生

電話：02-2737-7280

信箱：jklin@most.gov.tw



第一年 __年__月__日 至 __年__月__日	主導公司投入研發經費 (A1)		%
	共同執行公司一投入研發經費 (B1)		%
			%
	合計 (S1=A1+B1+...)		100%
第二年 __年__月__日 至 __年__月__日	主導公司投入研發經費 (A2)		%
	共同執行公司一投入研發經費 (B2)		%
			%
	合計 (S2=A2+B2+...)		100%
主導公司計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同執行公司一計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
主導學研機構計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		
共同學研機構一計畫連絡人	姓名：	聯絡電話：	
	E-mail：		

### 參、計畫內容說明

填寫說明：此部份為主要內容，請以精準、扼要之敘述為原則。

#### 一、研究目的

## 二、執行方法及團隊分工

### (一) 執行方法

填寫說明：建議分別概述業界出資合作部份與申請科技部補助部份之研發內容，說明兩者之關聯性；後者之研發內容應較前者更具前瞻性。另請簡述計畫研究流程或進行步驟。

#### 【合作企業出資部份】

第一年

第二年

#### 【申請科技部補助部份】

第一年

第二年

### (二) 團隊分工

填寫說明：請概述主導公司、各共同執行公司及學研機構在計畫中之合作架構或搭配方式。

## 三、預期產出與成果效益

填寫說明：請列述預期之研發標的與技術指標，並明確區別業界出資合作部份與申請科技部補助部份之產出與成果；後者可在說明學術價值之外，強調產業技術提升或產學合作加值效應等。

## 肆、附件

說明：請檢附「申請人與企業之合作約定書」或申請人與企業之合作合約做為佐證材料。

## 【申請人與合作企業之合作約定書】

本企業（名稱：\_\_\_\_\_）願參與半導體產學研發聯盟計畫（名稱：\_\_\_\_\_），（總）計畫主持人：\_\_\_\_\_），並遵守下列事項：

- 一、本企業與（總）計畫主持人等合作，全程參與本研究計畫，並保證提供申請機構研發經費全程總計新臺幣\_\_\_\_\_仟元。
- 二、廠商分年撥付研發經費（單位：仟元）  
第一年：            第二年：            第三年：
- 三、合作期間：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。
- 四、本企業所撥付經費，並非來自政府補助款項。

此致

科技部

合作企業負責人：\_\_\_\_\_（簽章）

合作企業印 鑑：

（備註：至少應由合作企業授權之研發部門主管簽章，毋須加蓋企業之公司大、小章。）

附件3

## 【○○○○推薦計畫證明文件】(參考格式)

申請人\_\_\_\_\_吸引業界\_\_\_\_\_投入屬產業前瞻技術  
研究與開發(合作主題:\_\_\_\_\_ )之研發經費,滿足下列條件:

1. 投入經費執行期間:自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止
2. 企業承諾出資研發總經費:\_\_\_\_\_仟元  
(第一年:\_\_\_\_\_仟元;第二年:\_\_\_\_\_仟元;第三年:\_\_\_\_\_仟元)

3. 檢附【申請人與企業之合作合約】

檢附【申請人與企業之合作約定書】以茲為證

本機構推薦此計畫申請科技部**半導體產學研發聯盟計畫**。

此致

科技部

計畫推薦機構負責人:\_\_\_\_\_ (簽章)

計畫推薦機構印 鑑:\_\_\_\_\_ (機構章)

中華民國 年 月 日